

252P 系列

开机成本低

- 面向教育科研用户，成形缸较小，因此开机需要的材料少，开机成本低。

材料适应广

- 采用滚筒铺粉方式，对于材料的适用性非常强，打印成功率高。

操作维护易

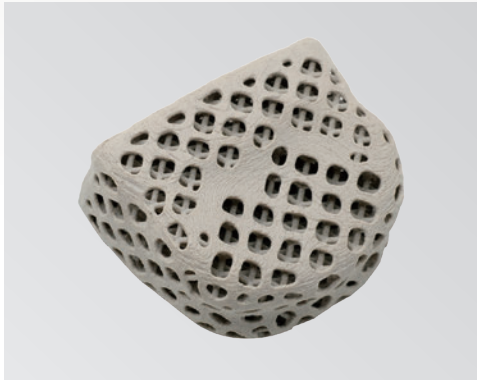
- 用户体验非常人性化，活塞清洁位置设计科学合理，粉末清理十分便捷。

烧结温度高

- ST252P具有280°C高温烧结能力。UT252P具有350°C超高温烧结能力，能够打印PPS、PEEK等材料。

深度开源

- 主要的温场和能量参数开放用户，非常适合科研培训与新材料的研发应用。



样品名称：PEEK新材料医疗件
打印设备：UT252P
打印材料：PEEK

该样件采用了华曙高科全新开发超高温高分子材料3D打印解决方案，并实现340°C熔点高温材料稳定高效烧结。PEEK材料的成功烧结，也标志着华曙高科高分子3D打印设备全面覆盖190°C-340°C的材料烧结温度。满足各行业材料烧结需求。

| 技术参数 | ST252P | UT252P |
|----------------------------|--|----------------------|
| 外形尺寸 (L×W×H) | 1735mm×1225mm×1975mm | 1735mm×1205mm×1975mm |
| 成形缸尺寸 ¹ (L×W×H) | 250mm×250mm×320mm | |
| 设备净重 | 约 1700kg | 约 2500kg |
| 铺粉层厚 | 0.06~0.3mm可调 | |
| 扫描速度 | 最高达 10m/s | |
| 激光系统 | CO ₂ 激光器, 100W | |
| 振镜扫描系统 | 定焦 | |
| 最高建造腔体温度 | 280°C | 350°C |
| 热场控制 | 智能分区独立控制 | |
| 温度控制 | 连续实时表面温度监测 | |
| 操作系统 | 64 位 Windows10 | |
| 数据处理及系统控制软件 | BuildStar, MakeStar® | |
| 软件功能 | 开源参数调节，可实时修改建造参数，三维可视化，诊断功能 | |
| 数据格式 | STL | |
| 电源要求 | 380V±10%，3~N/PE, 50Hz/60Hz, 32A | |
| 运行环境温度 | 22-28°C | |
| 成形材料 | FS3300PA, FS3401GB, FS4100PA, FS6140GF, WANFAB-PU95AB, Ultrasint® TPU 88A black, PEEK (仅UT)等 | |

¹ 实际成形体积与材料，工件等要素相关。